

奇景光電在2018年MWC推出領先業界的3D感測解決方案Android智慧型手機

【台南，2018年2月27日】奇景光電（納斯達克代號：HIMX）今（27）日宣布，在西班牙巴塞隆納舉行的2018年世界移動通訊大會（MWC）上，推出具備業界最高品質、卓越臉部識別能力及3D感測整體解決方案的Android智慧型手機樣品。奇景的3D感測整體解決方案，已完成量產與出貨準備。

奇景於2017年8月與高通聯合宣布SLiM™整體解決方案（Structured Light Imaging Module），將高通領先業界的3D演算法，結合奇景先進的繞射光學元件、近紅外光（NIR，Near Infrared）感測器的尖端設計和製造能力，以及獨特的3D感測系統整合技術，提供市場最高端智慧型手機的3D感測需求。奇景與高通聯合宣布推出的3D感測整體解決方案，是目前Android智慧型手機市場上，性能最佳的3D感測和臉部辨識整體解決方案。

奇景SLiM™3D感測整體解決方案，主要功能包括下面八點：第一是點投影機（Dot Projector），將業界最高、超過33,000個隱形點投射到物體上，在所有結構光解決方案中，建構最複雜的3D深度地圖；第二是深度地圖精準度，在整個20至100公分的操作範圍內，誤差率小於1%；第三是臉部識別，透過啟用最複雜的3D深度地圖，建構獨特的臉部特徵地圖，可用於即時解鎖及安全的線上支付（secure online payment）；第四是室內及室外靈敏度，即使在完全黑暗或明亮的陽光下，亦具有出色的辨識能力；第五是眼睛安全，已通過國際雷射產品標準IEC 60825一級認證，該認證主要是規範雷射在所有肉眼正常使用條件下的產品安全；第六是玻璃破碎偵測機制，當點投影機中發生玻璃破裂事故時，雷射會自動關閉；第七是低功耗，以低於400mW的點投影機、近紅外光影像感測器及3D深度解碼功能的組合，成為現有結構光的最低功耗解決方案；第八是小型化模組尺寸，是市場上最小的結構光解決方案，為嵌入式及行動裝置的理想選擇。

奇景光電執行長吳炳昌表示，3D感測是智慧型手機最重要的新功能之一。奇景SLiM™整體解決方案，現在已經可以進行量產，在工程每一面向及整體來說，性能表現皆優於Android市場的同業。奇景正與多家頂級智慧型手機廠合作，與客戶共同努力，目標為在2018年上半年開始推出Android高階3D感測智慧型手機。

關於奇景光電：

本公司係全球顯示器驅動IC與時序控制IC領先廠商，產品應用於電視、筆記型電腦、桌上型電腦、手機、平板電腦、數位相機、汽車導航、虛擬實境裝置以及其他多種消費性電子產品。奇景光電的其他產品並包含觸控面板控制IC、手持式與擴增實境裝置使用的頭戴式矽控液晶光閥（LCOS）微型投影解決方案、汽車使用的抬頭顯示器、LED驅動IC、電源管理IC、監視器及投影機控制晶片、客製化影像處理晶片解決方案及提供矽智權的授權等。奇景光電亦提供數位相機解決方案，包括用於擴增實境裝置、3D感測及機器視覺的CMOS影像感測器及晶圓級光學鏡頭，這些產品已被廣泛地應用在手機、平板電腦、筆記型電腦、電視、網路攝影機、汽車、保全、醫療器材及物聯網等。奇景光電設立於2001年，總部位於台灣台南，目前員工人數約為2,150人，分布於台南、新竹、台北、中國、韓國、日本與美國。至2017年12月31日為止，奇景光電在全球已取得3,032項專利，尚有424項專利正在申請中，產品應用於全球各種消費性電子品牌產品，技術領先並維持影像顯示處理技術半導體解決方案領導廠商的地位。

聯絡人：

黃華珮 / Jessica Huang
公共關係 專案經理
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-3-516-3276 分機 38817
jessica_huang@himax.com.tw

劉欣杰 / Ken Liu
投資人關係 專案副理
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-2-2370-3999 分機 22513
ken_liu@himax.com.tw

林芳妃 / Ophelia Lin
投資人關係 專案副處長
奇景光電股份有限公司
Himax Technologies, Inc.
+886-2-2370-3999 分機 22202
ophelia_lin@himax.com.tw

Investor Relations - US Representative
Greg Falesnik, Managing Director
MZ North America
Tel: +1-212-301-7130
Email: greg.falesnik@mzgroup.us
www.mzgroup.us

風險說明：

本新聞稿的部分展望未來的陳述，特別是有關於財務、產業預測，可能會導致實際結果與本新聞稿的描述不同，可能造成差異的因素包括但不限於整體市場與經濟的狀況、半導體產業的狀況、市場對本公司驅動IC產品及非驅動IC產品之接受度、產品競爭力、

市場競爭、終端市場需求、對少數主要客戶的依賴度、持續創新的技術、新面板技術發展、發展與維護智慧財產權的能力、價格壓力如平均售價下滑或客戶訂單模式改變、全年有效稅率預估的改變、面板其他關鍵零組件短缺、政策法規改變、匯率波動、子公司新投資案、對客戶應收帳款的回收與存貨的管理、維護及吸引人才，包括本公司為 2016 年度所申報的 20-F 文件中「風險因素」標題項下的該等風險。不論是否有其他新的訊息或事件，本公司皆無義務公開更新或修改此風險說明。